

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一九年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2020年2月13日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一九年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一九年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 2.428 億美元，同比下降 2.5%，環比增長 1.6%。
- 毛利率 27.2%，同比下降 6.8 個百分點，環比下降 3.8 個百分點。
- 期內溢利 1,400 萬美元，上年同期為 4,860 萬美元，上季度為 4,440 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 2,620 萬美元，上年同期為 4,900 萬美元，上季度為 4,520 萬美元。
- 基本每股盈利 0.020 美元，上年同期為 0.042 美元，上季度為 0.035 美元。
- 淨資產收益率（年化） 4.8%。

二零一九年度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入創歷史新高，達 9.326 億美元，較上年度增長 0.2%。
- 毛利率 30.3%，較上年度下降 3.1 個百分點。
- 年內溢利 1.550 億美元，上年度為 1.856 億美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.622 億美元，上年度為 1.832 億美元。
- 基本每股盈利 0.126 美元，上年度為 0.171 美元。
- 淨資產收益率 7.4%。

二零二零年第一季度指引

- 我們預計銷售收入約 2 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 21%至 23%之間。

二零一九年度股利派發

- 公司將會在二零二零年五月召開的周年大會上，決定二零一九會計年度股利分配方案。

總裁致辭

本公司總裁兼執行董事唐均君先生，對第四季度的業績評論道：

“我很高興與大家分享我們公司 2019 年第四季度的業績。如大家所知，公司管理層為第四季度設定了極具挑戰性的 2.42 億美元的銷售收入目標。我們深知這是一項艱巨的任務。實際上，公司第四季度銷售收入達到了 2.428 億美元，這是我們整個團隊在充滿挑戰的市場環境中精誠合作、勳力同心所取得的成績。尤為關鍵的是，新建的無錫 12 吋生產綫實現 740 萬美元的出貨目標，這對公司未來的發展意義重大。本季度毛利率為 27.2%。毛利率下滑主要由於產能利用率下降及人員開支增加。無錫新廠於第四季度正式投產，我們對此非常自豪。”

“在當前日益增長的 5G 智慧手機市場中，公司目前為國內外多家頂尖客戶提供基於 8 吋平臺的嵌入式閃存、功率分立器件、RF-SOI 和電源管理方面的技術支持。我們的技術研發團隊也一如既往地在為日益增長的 5G 智慧手機市場蓄力，為今年將在無錫 12 吋廠投產的相關產品研發更先進的技術。我們在這一新建的產綫上看到了生產各類產品的絕佳機會，例如智能卡芯片、MCU、功率分立器件、CIS、邏輯及射頻芯片。客戶們對此興趣濃厚。對於公司管理層而言，當前首要任務是確保 12 吋產綫能平穩迅速地完成爬坡上量，儘快為公司的收入和利潤增長做出貢獻。”

“2019 年對華虹半導體來說是非常了不起的一年。”唐先生在回顧公司全年業績時這樣評價道。“2019 年半導體行業環境充滿挑戰，而公司不僅新建了先進的 12 吋生產綫，且整體經營業績也表現得十分強勁，可圈可點。我為此深感自豪。根據美國半導體行業協會的分析，2019 年全球半導體市場下挫 12%，但我們公司的銷售收入總額達 9.326 億美元，較上年度增長 0.2%。收入表現不凡主要得益於 MCU、超級結、IGBT 和通用 MOSFET 產品的需求增加，尤其是在中國、亞洲其他地區及歐洲。毛利率 30.3%，較上年度下降 3.1 個百分點，主要由於產能利用率降低、人員開支上升及原材料單位成本增加，部分被平均銷售價格上升所抵消。淨利潤率 16.6%。”

唐先生總結道，“我深感榮幸能領導一個傑出的團隊。我們將無懼挑戰，繼續致力於完成無錫產能爬坡的任務。我有信心，在股東和董事會的支持下，我們會引領公司達到一個新的高度。”

電話會議公告

日期： 二零二零年二月十四日（星期五）

時間： 下午 04:00（上海 / 香港）
上午 03:00（紐約，2020 年 2 月 14 日，星期五）

發言人： 唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或

<https://event.on24.com/wcc/r/2181111/6884493CF63B6B5886EBBFA065AD9C7C>

電話詳細：

中國	+86 400 037 6502
香港	+852 5803 3043
臺灣	+852 800 931 446
新加坡	+65 3158 2645
紐約	+1 646 307 1851

電話會議登入名： 789450#

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（“本公司”）是全球領先的純晶圓代工企業，特別專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯及射頻等差異化特色工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 200mm 晶圓廠（華虹一廠、二廠、及三廠），月產能約 17.8 萬片；同時在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 300mm 集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	242,784	249,086	238,993	(2.5)%	1.6 %
銷售成本	(176,755)	(164,508)	(164,981)	7.4 %	7.1 %
毛利	66,029	84,578	74,012	(21.9)%	(10.8)%
毛利率	27.2 %	34.0 %	31.0 %	(6.8)	(3.8)
經營開支	(71,361)	(38,819)	(40,184)	83.8 %	77.6 %
其他收入淨額	24,145	11,620	23,517	107.8 %	2.7 %
稅前溢利	18,813	57,379	57,345	(67.2)%	(67.2)%
所得稅開支	(4,785)	(8,818)	(12,924)	(45.7)%	(63.0)%
期內溢利	14,028	48,561	44,421	(71.1)%	(68.4)%
淨利潤率	5.8 %	19.5 %	18.6 %	(13.7)	(12.8)
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	26,186	48,972	45,225	(46.5)%	(42.1)%
非控股權益	(12,158)	(411)	(804)	2,858.2 %	1,412.2 %
持有人應佔每股盈利					
基本	0.020	0.042	0.035	(52.4)%	(42.9)%
攤薄	0.020	0.042	0.035	(52.4)%	(42.9)%
付運晶圓(折合 8 吋矽片)	515	531	524	(3.0)%	(1.7)%
產能利用率 ¹	88.0 %	96.7 %	96.5 %	(8.7)	(8.5)
淨資產收益率 ²	4.8 %	9.6 %	8.4 %	(4.8)	(3.6)

二零一九年第四季度

- 銷售收入 2.428 億美元，同比下降 2.5%，主要由於晶圓銷售量下降；環比增長 1.6%。
- 銷售成本 1.768 億美元，同比上升 7.4%，主要由於人員開支、原材料單位成本及折舊費用的上升所致；環比上升 7.1%，主要由於人員開支及折舊費用的上升所致。
- 毛利率 27.2%，同比下降 6.8 個百分點，主要由於產能利用率降低，及人員開支、原材料單位成本及折舊費用的上升所致；環比下降 3.8 個百分點，主要由於產能利用率降低，及人員開支和折舊費用的上升所致。
- 經營開支 7,140 萬美元，同比上升 83.8%，環比上升 77.6%，主要由於無錫工廠的人員開支、研發工程片開支及折舊費用的上升所致。
- 其他收入淨額 2,410 萬美元，同比上升 107.8%，主要由於(i)政府補貼增加，(ii)匯兌損失減少，及(iii)分佔一家聯營公司溢利增加。
- 期內溢利 1,400 萬美元，上年同期為 4,860 萬美元，上季度為 4,440 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 2,620 萬美元，上年同期為 4,900 萬美元，上季度為 4,520 萬美元。
- 基本每股盈利 0.020 美元，上年同期為 0.042 美元，上季度為 0.035 美元。
- 淨資產收益率（年化） 4.8%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	235,370	249,086	238,993	(5.5)%	(1.5)%
毛利	66,427	84,578	74,012	(21.5)%	(10.2)%
毛利率	28.2 %	34.0 %	31.0 %	(5.8)	(2.8)
經營開支	(37,997)	(33,050)	(26,883)	15.0 %	41.3 %
稅前溢利	43,625	58,924	58,984	(26.0)%	(26.0)%
稅息折舊及攤銷前利潤	76,446	89,964	85,092	(15.0)%	(10.2)%
稅息折舊及攤銷前利潤率	32.5 %	36.1 %	35.6 %	(3.6)	(3.1)
付運晶圓(8 吋仟片)	506	531	524	(4.7)%	(3.4)%
華虹無錫					
銷售收入	7,414	-	-	不適用	不適用
毛利	(398)	-	-	不適用	不適用
毛利率	(5.4)%	-	-	(5.4)	(5.4)
經營開支	(33,364)	(5,769)	(13,301)	478.3 %	150.8 %
稅前溢利	(24,812)	(1,545)	(1,639)	1,506.0 %	1,413.8 %
稅息折舊及攤銷前利潤	(17,555)	(2,338)	(1,639)	650.9 %	971.1 %
稅息折舊及攤銷前利潤率	(236.8)%	-	-	(236.8)	(236.8)
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	9	-	-	不適用	不適用

華虹 8 吋

- 銷售收入 2.354 億美元，同比下降 5.5%，環比下降 1.5%，主要由於晶圓銷售量下降。
- 毛利率 28.2%，同比下降 5.8 個百分點，環比下降 2.8 個百分點，主要由於產能利用率降低，及人員開支和折舊成本上升所致。
- 經營開支 3,800 萬美元，同比上升 15.0%，主要由於人員費用和研發費用上升所致；環比上升 41.3%，主要由於人員費用和設備減值準備的上升所致。
- 稅前溢利 4,360 萬美元，同比下降 26.0%，環比下降 26.0%。

華虹無錫

- 銷售收入 740 萬美元。
- 經營開支 3,340 萬美元，去年同期為 580 萬美元，上季度為 1,330 萬美元，主要由於人員費用、研發工程片費用，及折舊費用的上升所致。
- 稅前虧損為 2,480 萬美元。
- 稅息折舊及攤銷前虧損 1,760 萬美元。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (已審核)	同比
銷售收入	932,567	930,268	0.2 %
銷售成本	(650,107)	(619,114)	5.0 %
毛利	282,460	311,154	(9.2)%
毛利率	30.3 %	33.4 %	(3.1)
經營開支	(178,624)	(130,094)	37.3 %
其他收入淨額	77,737	39,995	94.4 %
稅前溢利	181,573	221,055	(17.9)%
所得稅開支	(26,588)	(35,447)	(25.0)%
年內溢利	154,985	185,608	(16.5)%
淨利潤率	16.6 %	20.0 %	(3.4)
以下各方應佔利潤：			
母公司擁有人	162,237	183,158	(11.4)%
非控股權益	(7,252)	2,450	(396.0)%
持有人應佔每股盈利			
基本	0.126	0.171	(26.3)%
攤薄	0.125	0.169	(26.0)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,974	2,016	(2.1)%
產能利用率	91.2 %	99.2 %	(6.9)
淨資產收益率	7.4 %	10.2 %	(2.8)

二零一九年度

- 銷售收入創歷史新高，達 9.326 億美元，較上年度增長 0.2%。
- 銷售成本 6.501 億美元，較上年度上升 5.0%，主要由於人員開支、原材料單位成本及折舊費用的上升所致。
- 毛利率 30.3%，比上年度下降 3.1 個百分點，主要由於產能利用率的下降，及人員開支、原材料單位成本及折舊成本的上升，部分被平均銷售價格上升所抵消。
- 經營開支 1.786 億美元，較上年度上升 37.3%，主要由於無錫工廠的人員開支、研發工程片及折舊費用的上升所致。
- 其他收入淨額 7,770 萬美元，比上年度上升 94.4%，主要由於(i)政府補貼增加，(ii)匯兌損失減少，(iii)以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產取得公允價值變動收益增加，及(iv)利息收入增加。
- 年內溢利 1.550 億美元，上年度為 1.856 億美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 1.622 億美元，上年度為 1.832 億美元。
- 基本每股盈利 0.126 美元，上年度為 0.171 美元。
- 淨資產收益率 7.4%。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	233,385	96.1%	244,073	98.0%	(10,687)	(4.4)%
其他	9,399	3.9%	5,013	2.0%	4,385	87.5 %
銷售收入總額	242,784	100.0%	249,086	100.0%	(6,302)	(2.5)%

- 本季度 96.1% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按分部劃分的 銷售收入	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
華虹 8 吋	235,370	96.9%	249,086	100.0%	(13,716)	(5.5)%
華虹無錫	7,414	3.1%	-	-	7,414	不適用
銷售收入總額	242,784	100.0%	249,086	100.0%	(6,302)	(2.5)%

- 本季度來自於華虹 8 吋和華虹無錫的銷售收入分別為 2.354 億美元及 740 萬美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	153,476	63.2%	136,324	54.6%	17,152	12.6%
亞洲 ⁴	32,549	13.4%	34,339	13.8%	(1,790)	(5.2)%
美國	31,928	13.2%	41,267	16.6%	(9,339)	(22.6)%
歐洲	16,820	6.9%	19,078	7.7%	(2,258)	(11.8)%
日本 ⁵	8,011	3.3%	18,078	7.3%	(10,067)	(55.7)%
銷售收入總額	242,784	100.0%	249,086	100.0%	(6,302)	(2.5)%

- 本季度來自於中國的銷售收入 1.535 億美元，占銷售收入總額的 63.2%，同比增長 12.6%，主要得益於 MCU 和超級結產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,250 萬美元，同比減少 5.2%，主要由於 MCU 和通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度來自於美國的銷售收入 3,190 萬美元，同比減少 22.6%，主要由於超級結和通用 MOSFET 產品的需求減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,680 萬美元，同比減少 11.8%，主要由於智能卡芯片的需求減少，部分被通用 MOSFET 產品需求增加所抵消。
- 本季度來自於日本的銷售收入 800 萬美元，同比減少 55.7%，主要由於邏輯、超級結及 MCU 產品的需求減少。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	98,028	40.3%	99,447	39.9%	(1,419)	(1.4)%
分立器件	87,879	36.2%	86,869	34.9%	1,010	1.2%
模擬與電源管理	30,327	12.5%	31,405	12.6%	(1,078)	(3.4)%
邏輯及射頻	23,046	9.5%	27,624	11.1%	(4,578)	(16.6)%
獨立非易失性存儲器	3,322	1.4%	3,581	1.4%	(259)	(7.2)%
其他	182	0.1%	160	0.1%	22	13.8%
銷售收入總額	242,784	100.0%	249,086	100.0%	(6,302)	(2.5)%

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 9,800 萬美元，同比減少 1.4%，主要由於智能卡芯片的需求減少，部分被 MCU 產品的需求增加所抵消。
- 本季度分立器件銷售收入 8,790 萬美元，同比增長 1.2%，主要由於 IGBT 及超級結產品的需求增加，部分被通用 MOSFET 產品的需求減少所抵消。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 3,030 萬美元，同比減少 3.4%，主要由於模擬和 LED 照明產品需求減少，部分被電源管理產品需求增加所抵消。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 2,300 萬美元，同比減少 16.6%，主要由於邏輯和射頻產品的需求減少。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 330 萬美元，同比減少 7.2%，主要由於閃存產品的需求減少。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
0.13μm 及以下	87,228	35.9%	95,431	38.3%	(8,203)	(8.6)%
0.15μm 及 0.18μm	30,566	12.6%	36,396	14.6%	(5,830)	(16.0)%
0.25μm	3,056	1.3%	3,345	1.3%	(289)	(8.6)%
0.35μm 及以上	121,934	50.2%	113,914	45.8%	8,020	7.0 %
銷售收入總額	242,784	100.0%	249,086	100.0%	(6,302)	(2.5)%

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 8,720 萬美元，同比減少 8.6%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,060 萬美元，同比減少 16.0%，主要由於邏輯和射頻產品的需求減少。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 310 萬美元，同比減少 8.6%，主要由於智能卡芯片的需求減少。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.219 億美元，同比增長 7.0%，主要由於智能卡芯片及 IGBT 產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一九年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一九年 第四季度 % (未經審核)	二零一八年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一八年 第四季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	152,444	62.8%	153,089	61.5%	(645)	(0.4)%
工業及汽車	62,971	25.9%	55,402	22.2%	7,569	13.7 %
通訊	17,663	7.3%	28,398	11.4%	(10,735)	(37.8)%
計算機	9,706	4.0%	12,197	4.9%	(2,491)	(20.4)%
銷售收入總額	242,784	100.0%	249,086	100.0%	(6,302)	(2.5)%

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.524 億美元，占銷售收入總額的 62.8%，同比減少 0.4%，主要由於智能卡芯片的需求減少，很大程度上被超級結產品的需求增加所抵消。。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 6,300 萬美元，同比增長 13.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 1,770 萬美元，同比減少 37.8%，主要由於邏輯、通用 MOSFET 及智能卡芯片的需求減少。
- 本季度計算機產品銷售收入 970 萬美元，同比減少 20.4%，主要由於通用 MOSFET 產品的需求減少。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	59	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	50	50
1 號晶圓廠 (300mm)	10	-	-
合計折合 8 吋產能	201	174	175
產能利用率 (200mm)	92.5%	96.7%	96.5%
產能利用率 (300mm)	31.6%	-	-
總體產能利用率	88.0%	96.7%	96.5%

- 本季度末月產能達 201,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 88.0%。

付運晶圓

約當 8 吋仟片晶圓	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	515	531	524	(3.0)%	(1.7)%

- 本季度付運晶圓 515,000 片，同比減少 3.0%，環比減少 1.7%。

經營開支分析

以千美元計	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,899	2,034	1,925	42.5 %	50.6 %
管理費用 ⁷	68,462	36,785	38,259	81.6 %	78.9 %
經營開支	71,361	38,819	40,184	83.8 %	77.6 %

- 經營開支 7,140 萬美元，同比上升 83.8%，環比上升 77.6%，主要由於無錫工廠的人員費用、研發工程片及折舊費用的上升所致。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

⁷ 管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

其他收入淨額

以千美元計	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,091	2,958	3,142	4.5 %	(1.6)%
利息收入	2,898	3,356	3,479	(13.6)%	(16.7)%
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	4,776	6,630	5,713	(28.0)%	(16.4)%
匯兌(損失)/收益	(2,185)	(5,394)	3,881	(59.5)%	(156.3)%
分佔一家聯營公司溢利	6,401	3,830	2,720	67.1 %	135.3 %
財務費用	(324)	(431)	(294)	(24.8)%	10.2 %
政府補貼	9,098	151	4,685	5,925.2 %	94.2 %
其他	390	520	191	(25.0)%	104.2 %
其他收入淨額	24,145	11,620	23,517	107.8 %	2.7 %

- 其他收入淨額 2,410 萬美元，同比上升 107.8%，主要由於(i)政府補貼增加，(ii)匯兌損失減少，及(iii)分佔一家聯營公司溢利增加。

現金流量分析

以千美元計	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一八年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所(用)/得現金流量淨額	(7,269)	91,939	70,682	(107.9)%	(110.3)%
投資活動所得/(用)現金流量淨額	4,040	50,342	(421,707)	(92.0)%	(101.0)%
融資活動所(用)/得現金流量淨額	(1,642)	341,703	(171)	(100.5)%	860.2 %
外匯匯率變動影響淨額	6,487	8,736	(8,812)	(25.7)%	(173.6)%
現金及現金等價物變動影響淨額	1,616	492,720	(360,008)	(99.7)%	(100.4)%

- 本季度經營活動所用現金流量淨額 730 萬美元，同比下降 107.9%，環比下降 110.3%，主要由於本季度貿易收款減少，及供應商付款和員工開支增加。
- 投資活動所得現金流量淨額 400 萬美元，其中(i)贖回以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產投資 1.051 億美元，(ii)收到政府對設備的補助 9,450 萬美元，(iii)利息收入 290 萬美元，及(iv)處置固定資產收到 70 萬美元；部分被(i)設備及無形資產投資支出 1.292 億美元，及(ii)定期存款投資 7,000 萬美元所抵消。
- 融資活動所用現金流量淨額 160 萬美元，其中包括(i)償還銀行貸款本金 210 萬美元，(ii)租賃負債支出 60 萬美元，及(iii)支付利息 10 萬美元，部分被股票期權行權發行股份收到款項 120 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)
資產總額	3,613,303	3,576,458
負債總額	530,711	556,098
所有者權益總額	3,082,592	3,020,360
資產負債率 ⁸	14.7%	15.5%

資本開支

以千美元計	二零一九年 第四季度 (未經審核)	二零一九年 第三季度 (未經審核)
華虹 8 吋	32,890	32,320
華虹無錫	96,315	427,485
合計	129,205	459,805

- 本季度資本開支 1.292 億美元，其中 9,630 萬美元用於華虹無錫。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)
存貨	142,087	133,117
貿易應收款項及應收票據	164,968	140,398
預付款項、按金及其他應收款項	113,453	103,889
應收關聯方款項	9,262	6,152
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	519,779	611,632
已凍結存款及定期存款	70,776	765
現金及現金等價物	476,286	474,670
流動資產總額	1,496,611	1,470,623
貿易應付款項	86,119	81,675
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	303,614	301,966
計息銀行借款	4,300	4,242
租賃負債	1,922	1,357
政府補助	40,641	76,497
應付關聯方款項	10,655	10,509
應付所得稅	28,088	27,461
流動負債總額	475,339	503,707
淨營運資金	1,021,272	966,916
速動比率	2.8x	2.7x
流動比率	3.1x	2.9x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	58	55
存貨周轉天數	70	74

- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.404 億美元上升至本季度末的 1.650 億美元，主要由於本季度銷售收入增長。
- 應收關聯方款項由上季度末的 620 萬美元上升至本季度末的 930 萬美元，主要由於一家關聯客戶的貿易應收款增加。
- 以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產由上季度末的 6.116 億美元下降至本季度末的 5.198 億美元，主要由於理財產品的贖回。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 80 萬美元上升至本季度末的 7,080 萬美元，主要由於投資定期存款。
- 政府補助由上季度末的 7,650 萬美元下降至本季度末的 4,060 萬美元，主要由於投資固定資產。
- 本季度末淨營運資金 10.213 億美元，流動比率 3.1。
- 本季度末貿易應收款項及應收票據周轉天數 58 天。
- 本季度末存貨周轉天數 70 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)
銷售收入	242,784	249,086	238,993
銷售成本	(176,755)	(164,508)	(164,981)
毛利	66,029	84,578	74,012
其他收入及收益	20,090	13,282	21,117
投資物業的公平值收益	163	247	-
銷售及分銷費用	(2,899)	(2,034)	(1,925)
管理費用	(68,462)	(36,785)	(38,259)
其他費用	(2,185)	(5,308)	(26)
財務費用	(324)	(431)	(294)
分佔一家聯營公司溢利	6,401	3,830	2,720
稅前溢利	18,813	57,379	57,345
所得稅開支	(4,785)	(8,818)	(12,924)
期內溢利	14,028	48,561	44,421
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	26,186	48,972	45,225
非控股權益	(12,158)	(411)	(804)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.020	0.042	0.035
攤薄	0.020	0.042	0.035
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,287,054,838	1,162,589,323	1,285,596,506
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,296,177,838	1,172,799,323	1,293,558,506

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (已審核)
銷售收入	932,567	930,268
銷售成本	(650,107)	(619,114)
毛利	282,460	311,154
其他收入及收益	69,091	43,613
投資物業的公平值收益	163	247
銷售及分銷費用	(8,828)	(7,771)
管理費用	(169,796)	(122,323)
其他費用	(406)	(11,106)
財務費用	(1,242)	(2,203)
分佔一家聯營公司溢利	10,131	9,444
稅前溢利	181,573	221,055
所得稅開支	(26,588)	(35,447)
年內溢利	154,985	185,608
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	162,237	183,158
非控股權益	(7,252)	2,450
持有人應佔每股盈利		
基本	0.126	0.171
攤薄	0.125	0.169
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,285,586,255	1,070,699,301
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,295,539,255	1,082,451,301

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (已審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	1,558,283	1,563,446	773,180
使用權資產	74,526	73,447	-
投資物業	168,615	166,148	171,225
預付土地租賃款項	-	-	58,989
無形資產	13,322	11,715	9,571
於聯營公司的投資	73,142	65,805	64,005
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	207,689	202,179	208,357
長期預付款項	6,740	8,376	3,762
應收關聯方款項	6,808	6,714	8,747
遞延稅項資產	7,567	8,005	6,363
非流動資產總額	2,116,692	2,105,835	1,304,199
流動資產			
存貨	142,087	133,117	129,629
貿易應收款項及應收票據	164,968	140,398	176,797
預付款項、按金及其他應收款項	113,453	103,889	12,479
應收關聯方款項	9,262	6,152	10,800
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	519,779	611,632	667,033
已凍結存款及定期存款	70,776	765	337
現金及現金等價物	476,286	474,670	777,000
流動資產總額	1,496,611	1,470,623	1,774,075
流動負債			
貿易應付款項	86,119	81,675	79,470
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	303,614	301,966	165,370
計息銀行借款	4,300	4,242	4,371
租賃負債	1,922	1,357	-
政府補助	40,641	76,497	44,406
應付關聯方款項	10,655	10,509	5,838
應付所得稅	28,088	27,461	30,114
流動負債總額	475,339	503,707	329,569
流動資產淨額	1,021,272	966,916	1,444,506
總資產減流動負債	3,137,964	3,072,751	2,748,705
非流動負債			
計息銀行借款	21,502	23,328	26,227
租賃負債	16,694	16,258	-
遞延稅項負債	17,176	12,805	18,146
非流動負債總額	55,372	52,391	44,373
淨資產	3,082,592	3,020,360	2,704,332
權益和負債權益			
股本	1,966,095	1,963,245	1,960,159
儲備	279,146	219,213	195,097
本公司擁有人應佔權益	2,245,241	2,182,458	2,155,256
非控股權益	837,351	837,902	549,076
權益總額	3,082,592	3,020,360	2,704,332

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一九年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一八年 (未經審核)	於九月三十日 二零一九年 (未經審核)
經營活動所(用)/得現金流量：			
稅前溢利	18,814	57,379	57,345
折舊及攤銷	39,754	29,816	25,814
應佔聯營公司溢利	(6,401)	(3,830)	(2,720)
營運資金的變動及其它	(59,436)	8,574	(9,757)
經營活動所(用)/得現金流量淨額	(7,269)	91,939	70,682
投資活動所得/(用)現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(129,206)	(60,982)	(459,805)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	94,519	-	-
其他投資活動所得現金流量	38,727	111,324	38,098
投資活動所得/(用)現金流量	4,040	50,342	(421,707)
融資活動所(用)/得現金流量：			
發行股份所得收益	1,204	400,523	29
償還銀行貸款	(2,150)	(58,331)	-
償還租賃負債	(612)	-	(114)
已付利息	(84)	(489)	(86)
融資活動所(用)/得現金流量	(1,642)	341,703	(171)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(4,871)	483,984	(351,196)
外匯匯率變動影響淨額	6,487	8,736	(8,812)
期初現金及現金等價物	474,670	284,280	834,678
期末現金及現金等價物	476,286	777,000	474,670

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (已審核)
經營活動所得現金流量：		
稅前溢利	181,573	221,055
折舊及攤銷	128,711	119,859
應佔聯營公司溢利	(10,131)	(9,444)
營運資金的變動及其它	(137,219)	(57,070)
經營活動所得現金流量淨額	162,934	274,400
投資活動所用現金流量：		
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(922,281)	(238,584)
收到政府對物業、廠房及設備的補助	94,519	-
其他投資活動所得/(用)現金流量	105,175	(478,655)
投資活動所用現金流量	(722,587)	(717,239)
融資活動所得現金流量：		
非控股權益出資	317,000	565,000
發行股份所得收益	2,550	403,956
向股東支付股息	(50,963)	(41,066)
已凍結存款的增加	(22)	(8)
償還銀行貸款	(4,332)	(60,613)
償還租賃負債	(975)	-
已付利息	(360)	(2,259)
融資活動所得現金流量	262,898	865,010
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(296,755)	422,171
外匯匯率變動影響淨額	(3,959)	(20,061)
年初現金及現金等價物	777,000	374,890
年末現金及現金等價物	476,286	777,000

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)
唐均君(總裁)

非執行董事

杜洋
森田隆之
王靖
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司
張素心
董事長兼執行董事

中國 香港
二零二零年二月十三日